研究ノート

高品質CVDダイヤモンドを用いた高感度検出器の開発

Application of High-Quality CVD Diamond to Highly-Sensitive Detectors Key Words : CVD, Microwave plasma, Diamond, Detector, Homoepitaxial growth

1.半導体ダイヤモンドの卓越した諸物性

軽元素の炭素のみで構成されるダイヤモンドは, 広いバンドギャップエネルギーで低誘電率の半導体 材料であり,短い結合長で強い共有結合を有するた め,最大の硬度,最高の絶縁破壊電界,最大の熱伝 導率等,いくつかの卓越した特徴を兼ね備えている (表1)¹⁾.このため,ダイヤモンドの高速・大電力 素子としての性能指数Johnson指数²⁾や高速・高集 積素子としてのKeys指数³⁾は,Siに比べれば桁違 いに大きく,高周波デバイス・パワーエレクトロニ クスデバイスの次世代材料として開発が進められて いるSiCやGaNに比しても数倍程度あり,SiCやGaN

平準体材料名物性領	ダイヤモンド C	シリコン Si
バンドギャップ (eV)	間接: 5.47	間様:1.11
高性半導体温度 (K)	3000	600
結合距離 (人)	1.544	2.325
熱伝導度 # (W/em/K)	20.9	1.51
比腈電丰 /	5.7	11.9
他和平タブト速度 Fs (em/s)	2.7×10^{7}	1.0×10 ⁷
能錄破標電算 Ea (V/cm)	1×10^3	3×10^3
Johnson 性能頻發 Mg	8300	1
Keys 性胞指数 Mg	33	- E

 $M_1 \propto (E_B F_S)^2$, $M_K \propto \kappa (F_S \kappa)^{1/2}$

表1 ダイヤモンドとSiの各種物性値(室温)の比較 (性能指数はSiに対する相対値)



* Toshimichi ITO 1952年7月生 大阪大学,工学部,電気工学科卒業 (1975年) 現在,大阪大学,大学院工学研究科,電 気電子情報工学専攻,教授,工学博士, 電気電子材料・半導体物性 TEL:06-6879-7702 FAX:06-6879-7704 E-mail:ito@eei.eng.osaka-u.ac.jp を越え得るエレクトロニクス材料の有力候補であ る.また,ダイヤモンドの化学的安定性や放射線耐 性のため,極限環境センサー・デバイスの材料とし て期待でき,強腐食環境下用の電極や広い電位窓を 有するため化学電極等としても使用される.他方, 水素終端ダイヤモンド表面の伝導帯下端は真空準位 より高くなるため,通常の冷陰極では電子の引き出 しに必要な外部高電界無しで,ディスプレイや真空 マイクロエレクトロニクス素子に不可欠な高輝度電 子エミッタが実現できると期待されている⁴⁾.

利道

伊藤

高出力MWPCVD法による ダイヤモンド薄膜合成

現状では高品質で大面積のダイヤモンドは容易に は形成できない.通常の温度・圧力領域では,炭素 の安定相はグラファイトであり,ダイヤモンドは高 温・超高圧下での安定相であるためである.自然界 に存在する天然ダイヤモンドは,地中深部の高温・ 超高圧下で形成されたものであり,人工ダイヤモン ドは,超高圧発生装置により合成される(highpressure/high-temperature synthesized, HPHT) O みであったが,近年,炭素成分を含む水素ガスを分 解しダイヤモンドを選択的に合成する気相合成法の 中でマイクロ波プラズマを用いた作製法 (microwave plasma chemical vapor deposition, MWPCVD)が発展してきた^{1,5)}. HPHT試料には, 不純物が取り込まれやすく,結晶の大型化にも限界 がある等の問題があり,ダイヤモンドの電子デバイ スへの応用には, MWPCVD技術の発展が不可欠で ある.

2.1.高品質アンドープダイヤモンド

室温ルミネセンススペクトルの主構造が励起子発



図1.ホモエピタキシャルダイヤモンド薄膜の 成長速度のメタンガス濃度依存性

光であることで特徴付けられる高品質CVDダイヤ モンドは(低品質の)HPHT(001) 基板上へのホモエ ピタキシャル成長によって得られる⁵⁾.図1は, MWPCVD法を用いて作製されるアンドープダイヤ モンド(001)ホモエピタキシャル薄膜の成長速度と 原料ガス中のメタン濃度との関係を表している⁶⁾. これまでのCVDダイヤモンド合成の研究により, 高品質ダイヤモンドは, MWPCVD法では, 1%以 下の低濃度メタン領域における成長速度の非常に小 さいホモエピタキシャル成長でなければ作製できな いと考えられてきた(図1の低メタン濃度領域)⁵⁾. しかし、上述の優れた特性を生かしたダイヤモンド デバイスの実現には,ダイヤモンドの結晶品質の向 上とともにその成長速度の大幅な増大が不可欠であ る.そこで我々は,高出力MWPを用いることによ り,従来は不適であるとされた高成長温度・高メタ ン濃度領域でホモエピタキシャル成長すれば,数µ m/h程度の現実的な成長速度で,高品質CVDダイ ヤモンド薄膜を形成できることを実証してきた⁶⁻¹¹⁾. 典型的な合成条件は,投入MW電力 3.8 kW,基板 温度 ≈1020 ,原料ガス濃度(CH₄/H₂比)4.0%,全 ガス流量200 sccmで,成長速度は,≈4 µm/h であ る.更に,近年我々は,研磨HPHT基板の表面処理 方法が成長膜の高品質化に及ぼす影響⁷⁾や,基板結 晶のオフ角制御がホモエピタキシャル膜の高品質化 や成長速度の増大にもたらす効果を見出しており, 今後もCVDダイヤモンド合成技術の更なる発展が 期待される⁸⁾.

2.2.ダイヤモンド薄膜のp-n伝導制御

周期律表の隣接 族軽元素であるホウ素をドープ することにより,p型ダイヤモンドは容易に形成さ れるが,そのアクセプター準位は0.37 eVもあるた め,室温近辺では励起確率が低く,低抵抗の試料を 作製するには,高濃度ドープが必要である.しかし, 図2に示すように,ドープ量の増大とともにキャリ ア移動度が低下する一般的傾向は,中・低出力 MWPを用いる従来法の場合に比して,我々の開発



した作製プロセスではかなり改善されるものの,実 用的には,高濃度領域での移動度の低下をさらに抑 制できる作製プロセスの開発が必要である⁶⁾.最近, このp型伝導制御においても,基板オフ角が重要な 制御パラメータであることを見出しており, 伝導制 御技術の更なる発展が期待できる¹⁰⁾.これに対し, n型ダイヤモンドの場合は, 試料そのものの作製が 容易でなく,その高品質化はなお更困難である.周 期律表の隣接V族原子の置換窒素は,ダイヤモンド 中で深い準位(伝導帯下端から 1.7 eV)を形成する ため常温ではドナーとはなりえない.現在までに確 認されている,室温近辺で有用な唯一のドナーは燐 であるが,結合距離がC原子と比べかなり大きいP 原子はダイヤモンド中には取り込みにくく、その活 性化エネルギーは, ≈0.6 eVもあり, アクセプター に比べ更に大きい結合エネルギーである.現状では 結晶性の良い(001)面でのn型試料の作製に成功した 報告例は限定されている11.我々も,より高い密度 のプラズマを用いて漸くn型ホモエピタキシャル (001 試料の作製に成功したところである12).なお, ダイヤモンドの伝導制御において,不純物バンドの 形成による活性化エネルギーの低減化への期待も残

生産と技術 第59巻 第4号(2007)



図3.試作したダイヤモンド軟X線検出器の概観

されている.

3.高品質ダイヤモンドを用いた高感度紫外線・ 軟×線検出器の試作

上述のように,バンドギャップ5.5 eVで,内殻電 子数が少ないダイヤモンドは,放射線耐性が強く, 深紫外領域や軟X線領域のフォトン検出に適した材 料の一つである.最もよく用いられているSi検出器 では,エネルギー分解能や検出感度を向上させるた めは,検出器自体の冷却機構が不可欠であるのに対 し,ダイヤモンドの場合は,そのような冷却機構は 不要となると期待される.試作したダイヤモンド検 出器で実測したところ,暗電流は印加電圧を増加し てもほとんど増加が見られず,市販のSi検出器に比 べ,概ね10⁻³以下である^{9,9}.大きさ3×3mm²のホ モエピタキシャルダイヤモンド上に形成した試作素 子の典型例を図3に示す.図4は,単位時間当たり



信号電流及び暗電流特性の印加電圧依存性例

の入射フォトン数が ≈4 ×10°個/sの場合における, フォトンエネルギー 400, 1000及び1800 eVの軟X線 に対して,観測された検出信号電流及び暗電流の印 加電圧依存性を示している¹³⁾.検出器への印加電圧 が入射フォトンのエネルギーに依存した閾値電圧を 超えると,信号電流が急激に増大していることが分 かる.この検出器では,電極近傍に高電界領域が局 所的に形成され、アバランシェ増幅が生じるような 構造となっている.ダイヤモンドにおける軟X線フ ォトンの侵入長は, そのエネルギーが 400 eVから 1800 eVへ増大すると, nm領域から≈10µmに亘り 大きく変化するにも拘わらず,検出器の量子効率は 照射フォトンのエネルギーが大きいほど増大してい る.これは,試作したダイヤモンド検出器では,励 起キャリアの拡散長が十分長く,ダイヤモンド層の 高品質性を反映している.また,閾値電圧より十分 大きい印加電圧では,信号電流は印加電圧の二乗に 比例するようになっているため,この電圧領域では 空間電荷制限電流機構が支配的になり、増幅電流が 全電極に亘って均一には流れていないことが示唆さ れる.紫外線領域についても信号電流の同様な印加 電圧依存性が観測され,試作したダイヤモンド検出 器は大きな増幅度を有するアバランシェ増幅機能14) を内蔵した高感度の紫外線・軟X線検出器として動 作することが実証された.通常,Si半導体を用いた 検出システムの場合,検出に十分な信号強度を得る ためは、外付けの前置増幅器が不可欠であり、検出 システムの大型化は避けられないのに対して,本ダ イヤモンド検出器は外付けの前置増幅器不要で小型 化できる可能性を示している.

他方,このような紫外線・軟X線の検出特性は, 光電子増倍管の代替品としてのダイヤモンドの有用 性を示唆しており,光学検出器の小型化やアレー化 につながるとともに,将来的には,シンチレーショ ン結晶との組合せにより,線を検出する陽電子断 層法(positron emission tomography, PET)やX線 コンピュータ断層法(computed tomography, CT) による医療診断装置への応用も期待される.特に, 診断技術の向上には,磁気共鳴画像法(magnetic resonance imaging, MRI)とのPETの併用が不可欠 であると考えられているが,PETで使用される光 電子増倍管は磁場に対する影響が強く,前者の強磁 場印加状態では使用不可能であるため,PETの信 号増幅には半導体中で生じるアバランシェ増幅が活 用されている.上述のダイヤモンドの検出特性は磁 場鈍感性を有しており,この分野への展開も期待さ れる.しかし,これらの実現のためには,ダイヤモ ンドの更なる高品質化,均質化,大面積化等が必要 であり,自在に素子構造を形成できる各種ダイヤモ ンドプロセス技術の開発無くしては実現できないの は言うまでもない.

4.まとめ

高出力MWPCVD法を用いれば,ホモエピタキシ ャルダイヤモンド薄膜の室温ルミネセンスで励起子 発光が支配的な高品質薄膜を数µm/h程度の成長速 度で形成できる.また,そのような高品質CVDダ イヤモンド薄膜を用いて作製した紫外線・軟X線検 出器は,室温で低い暗電流特性を示し,100V程度 の印加により10°倍以上の増幅度を有した高感度検 出器として動作することが実証できた.また,基板 オフ角の制御や合成パラメータの更なる調整によ り,今後も高品質化作製プロセス技術の進展が期待 される.さらに,産業に直結するCVDダイヤモン ドの電子デバイス化技術の中で残された最も重要な 開発課題は,大面積化技術の開発であるが,現時点 で,ヘテロエピタキシャル成長でその可能性が見出 されており⁽⁵⁾,今後の展開が待たれる.

参考文献

- " Handbook of Industrial diamonds and diamond films ", Eds. M. A. Prelas, G. Popovici and L. K. Bigelow, (Marcel Dekker, New York, 1998)
- 2) E. O. Johnson, RCA Rev. 26 (1965) 163.

- 3) R. Keys, Proc. IEEE 60 (1972) 225.
- 4) T. Ito, M. Nishimura, A. Hatta, Appl. Phys. Lett. 73 (1998) 3739; 伊藤利道, 生産と技術 49 (1997) 63.
- 5) H. Okushi, Diamond Relat. Mater 10 (2001) 281.
- 6) T. Teraji, T. Ito, J. Cryst. Growth 271 (2004)
 409; T. Teraji, M. Hamada, H. Wada, M.
 Yamamoto, T. Ito, Diamond Relat. Mater 14
 (2005) 1747.
- 7) M. Yamamoto, T. Teraji, T. Ito, J. Cryst.
 Growth 285 (2005) 130; M. Hamada, T. Teraji,
 T. Ito, Jpn. J. Appl. Phys. 44 (2005) L216.
- 8) H. Miyatake, O. Maida, T. Teraji, T. Ito, Diamond Relat. Mater 16 (2007) 679; O. Maida, H. Miyatake, T. Teraji, T. Ito, *ibid. submitted.*
- 9) T. Teraji, S. Yoshizaki, H. Wada, M. Hamada, T. Ito, Diamond Relat. Mater. 13 (2004) 858.
- 10) K. Arima, H. Miyatake, T. Teraji, T. Ito, J. Cryst. Grwoth, *submitted.*
- 11) H. Kato, S. Yamasaki and H. Okushi, Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 222111.
- 12) T. Nakai, O. Maida, T. Ito, *submitted* to the Fifth International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-5) Tokyo, Nov. 2007.
- H. Matsubara, Y. Saitoh, O. Maida, T. Teraji, K. Kobayashi, T. Ito, Diamond Relat. Mater 16 (2007) 1044.
- 14) T. Watanabe, T. Teraji, T. Ito, Y. Kamakura, K. Taniguchi, J. Appl. Phys. 95 (2004) 4866.
- 15) Y. Ando, J. Kuwabara, K. Suzuki, A. Sawabe, Diamond Relat. Meter. 13 (2004) 1975.